

广州方邦电子股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募 集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 经广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“研发中心建设项目”进行结项，本项目募集资金预计剩余金额 12,702.77 万元，将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照监管部门、公司相关管理规定做好募集资金管理；公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目，待审慎研究讨论确定后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资；在实施新项目投资之前，公司将使用该部分募集资金不超过人民币 12,000 万元临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途。公司董事会、监事会及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东会审议。

● “研发中心建设项目”原计划使用募集资金 20,206.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 10,092.45 万元，投入进度为 49.95%。该项目已于 2022 年 12 月达到可使用状态，处于研发项目实施阶段，截至目前，主要研发项目如无胶挠性覆铜板、高频信号传输用柔性基板等项目已实现量产，FCCL 产品持续迭代提升；可剥离的极薄电解铜箔项目（带载体可剥离超薄铜箔）已通过相关下游及终端测试认证，持续获得小批量订单，后续订单上量进度有望

加快。其他研发项目如液晶聚合物基板、导电胶膜、自由接地膜等项目因市场空间较为有限、客户需求发生变化等原因，公司根据实际情况减少了资金投入。综上，本项目已达到可使用状态，相关研发项目持续推进，较好促进了公司屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品的开发及迭代，增强了公司研发创新实力，达到了项目设计目的，现拟进行结项。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项，本项目结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照监管部门、公司相关管理规定做好募集资金管理；公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目，待审慎研究讨论确定后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资；在实施新项目投资之前，公司将使用该部分募集资金不超过人民币 12,000 万元临时补充流动资金。现就具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。

二、募投项目投入情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目的进展情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目	计划投资金额	调整后投资金额	累计投入金额	投入进度(%)	项目状态
1	挠性覆铜板生产基地建设项目	55,194.63	31,075.72	29,676.26	95.50	项目第一期已于 2022 年 12 月达到可使用状态；第二期于 2024 年 7 月初达到可使用状态，已实现 32.5 万平方米/月的产能，公司将终止后续产能建设（详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009）。
2	屏蔽膜生产基地建设项目	13,251.28	13,252.28	12,782.55	96.46	项目如期建成，设备如期完成安装调试，并于 2022 年 12 月完成环评验收，达到可使用状态，2023 年 2 月达到量产状态，已结项。
3	研发中心建设项目	20,206.00	20,206.00	10,092.45	49.95	拟结项，具体进展详见下文。
4	补充营运资金项目	9,252.05	9,252.05	9,315.09	100.68	不适用
	合计	97,903.96		61,866.35		

三、本次拟结项的募投项目进展情况、募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，截至 2025 年 6 月 30 日，主要项目如无胶挠性覆铜板、高频信号传输用柔性基板等项目已实现量产，FCCL 产品持续迭代提升；可剥离的极薄电解铜箔项目（带载体可剥离超薄铜箔）已通过相关下游及终端测试认证，持续获得小批量订单，后续订单上量进度有望加快。其他项目如液晶聚合物基板、导电胶膜、自由接地膜等项目因市场空间较为有限、客户需求发生变化等原因，公司根据实际情况减少了资金投入或为继续追加资金投入。综上，本项目已达到可使用状态，较好促进了公司屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品的开发及迭代，增强了公司研发创新实力，达到了项目设计目的，现拟进行结项。

本次结项募集资金投资项目具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金 拟投资总 额(A)	累计已实际 支付募集资 金金额(B)	已签订合 同待支付 金额(C)	利息及理财 收入扣除手 续费后净额 (D)	募集资金预计 剩余金额 (E=A-B-C+D)
研发中心建设项目	20,206.00	10,092.45	5.75	2,594.97	12,702.77

注：1、最终募集资金预计剩余金额以项目结项当日金额为准；

2、已签订合同待支付金额是公司根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。

四、本次结项项目募集资金结余的主要原因及后续使用计划

（一）“研发中心建设项目”募集资金结余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；同时，本项目的导电胶膜、自由接地膜等部分研发方向因市场空间较为有限、客户需求发生变化等原因，公司未继续追加资金投入；再者，本项目原计划购置的超高频溅射机、高温精密涂布机以及金属激光烧结系统为国外设备，价格较高，近年来在国家提倡科技自主可控及国内相关设备制造行业技术水平不断提升的大背景下，公司通过自研设备和采购国内设备的方式予以解决。以上措施均一定程度降低了本项目资金支出。

2、公司在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。

（二）结余募集资金后续使用计划

“研发中心建设项目”结项后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照监管部门、公司相关管理规定做好募集资金管理。

后续公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目，待审慎研究讨论确定后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资。

在实施新项目投资之前，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时更好的满足公司运营发展的资金需求，公司拟将使用该部分结余募集资金不超过 12,000 万元临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营

等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。

五、审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项，并使用本项目结余募集资金不超过 12,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为，本次部分募投项目结项并使用募集资金临时补充流动资金事项，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高募集资金使用效率、解决公司暂时的流动资金需求，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项并使用募集资金临时补充公司流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，自公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日